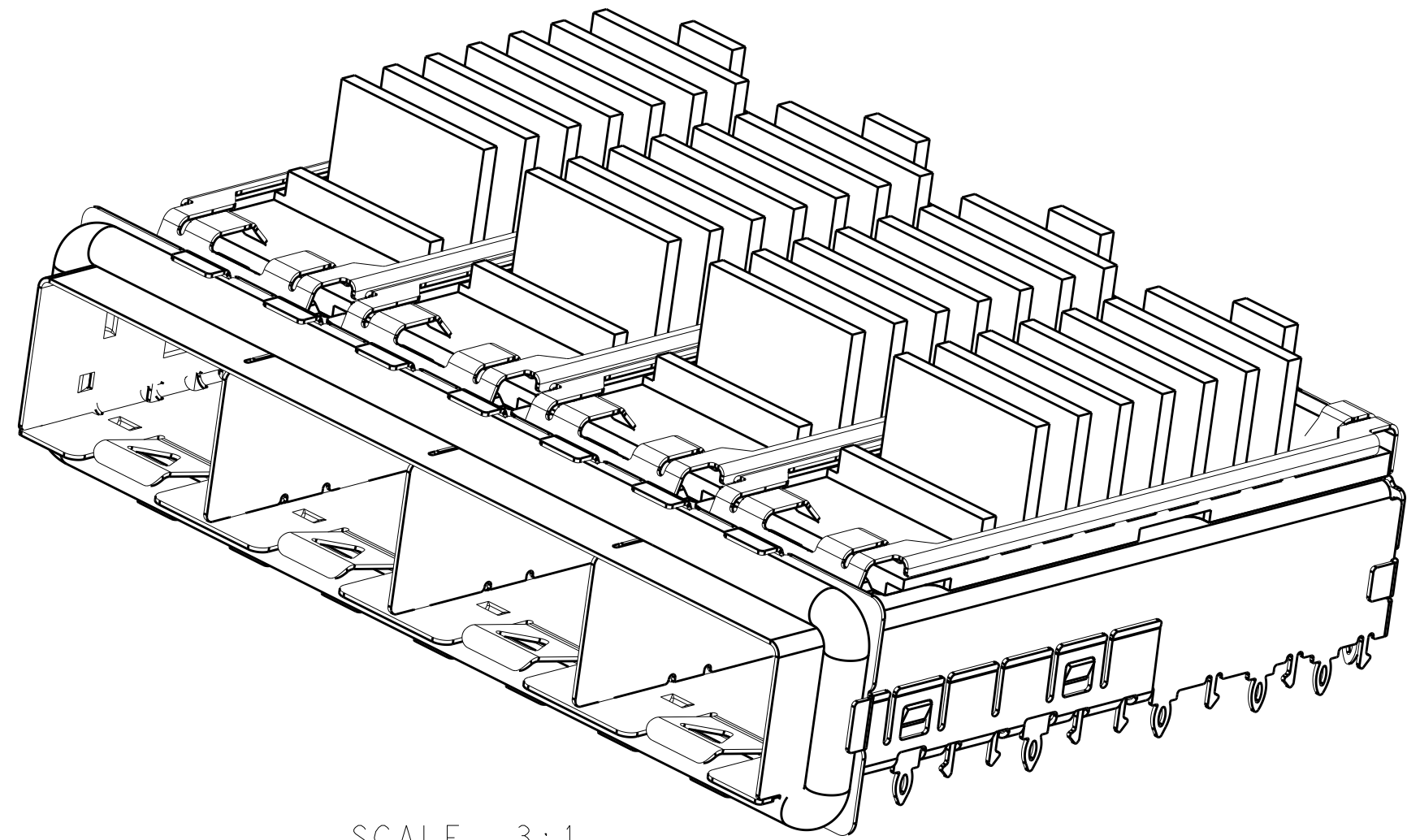


LOC	DIST	REVISIONS					
GP	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			A	REV PER ECR-12-004175	12MAR2012	DZ	AC
			B	REVISED	1JUN2012	DZ	AC
			B2	REV PER ECR-12-009968	10JULY2012	DZ	AC



SCALE 3:1

1 MATERIAL:
CAGE ASSEMBLY: 0.25mm THICK NICKEL SILVER ALLOY
GASKET RETENTION PLATE: STAINLESS STEEL
EMI GASKET: PLATED FILLED SILICONE
HEATSINK CLIP: STAINLESS STEEL
HEATSINK: ALUMINUM

2 FINISH:
HEATSINK: HARD ANODIC COAT
HEATSINK CLIP: PASSIVATE

3 PADS AND VIAS CHASSIS GROUND.

4 DATUM AND BASIC DIMENSION ESTABLISHED BY CUSTOMER.

5. MATES WITH SFP MSA COMPLIANT TRANSCEIVERS.

6. INTERPRETATION OF DATUM REFERENCE FRAME IN ACCORDANCE WITH SECT 4.4.1.1 OF ASME Y14.5M-1994.

7 REFERENCE APPLICATION SPEC. 114-13120, HOLE A, FOR RECOMMENDED DRILL HOLE DIAMETER AND PLATING THICKNESS.

8 REFERENCE APPLICATION SPEC. 114-13120, HOLE B, FOR RECOMMENDED DRILL HOLE DIAMETER AND PLATING THICKNESS.

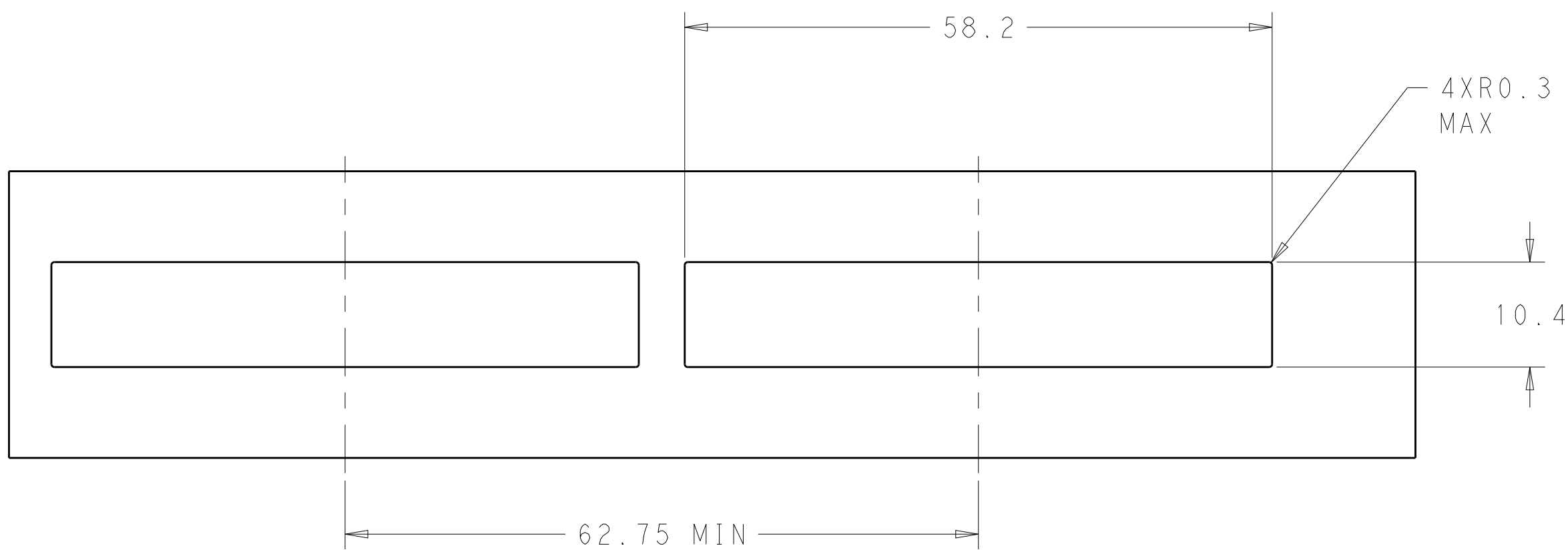
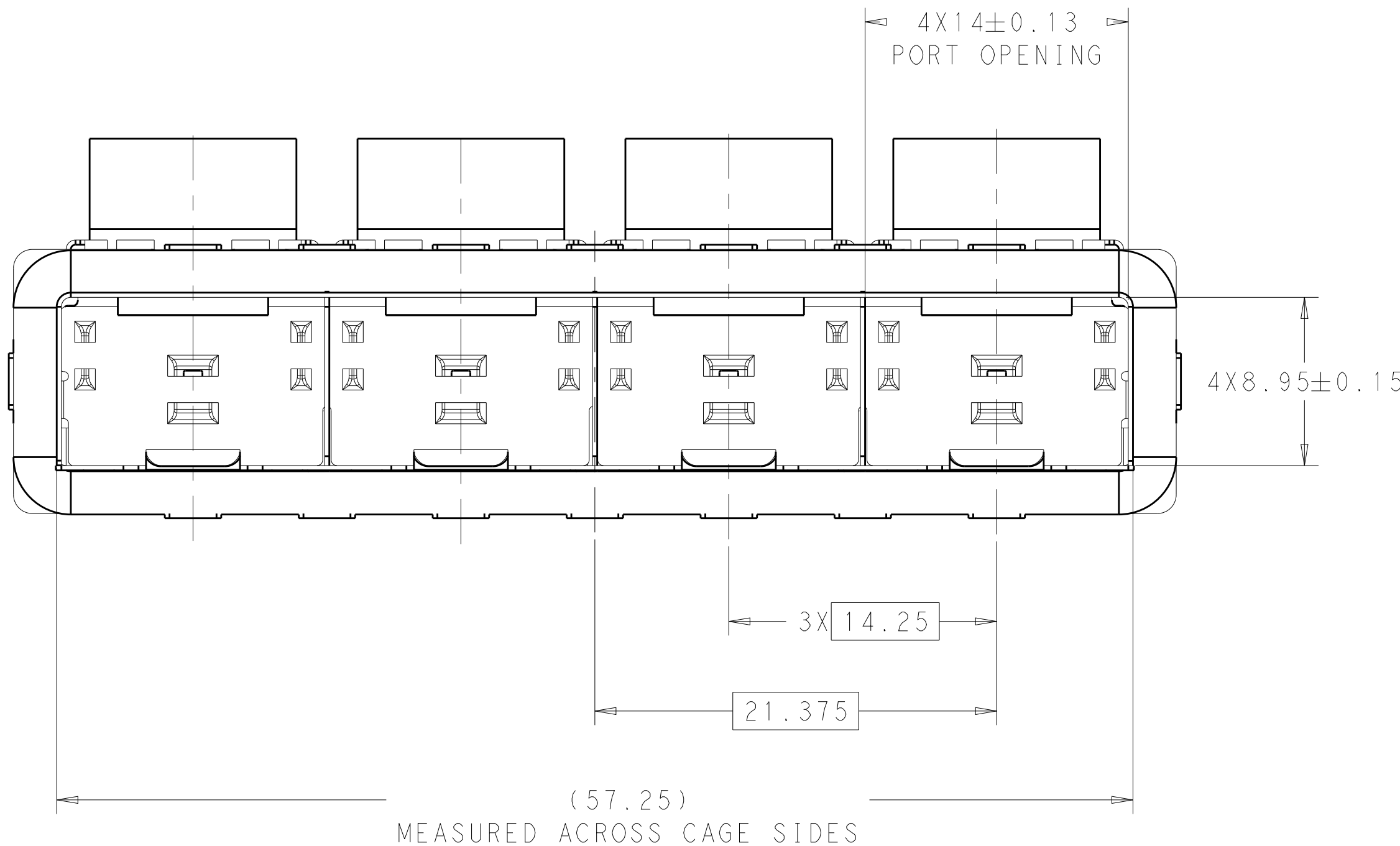
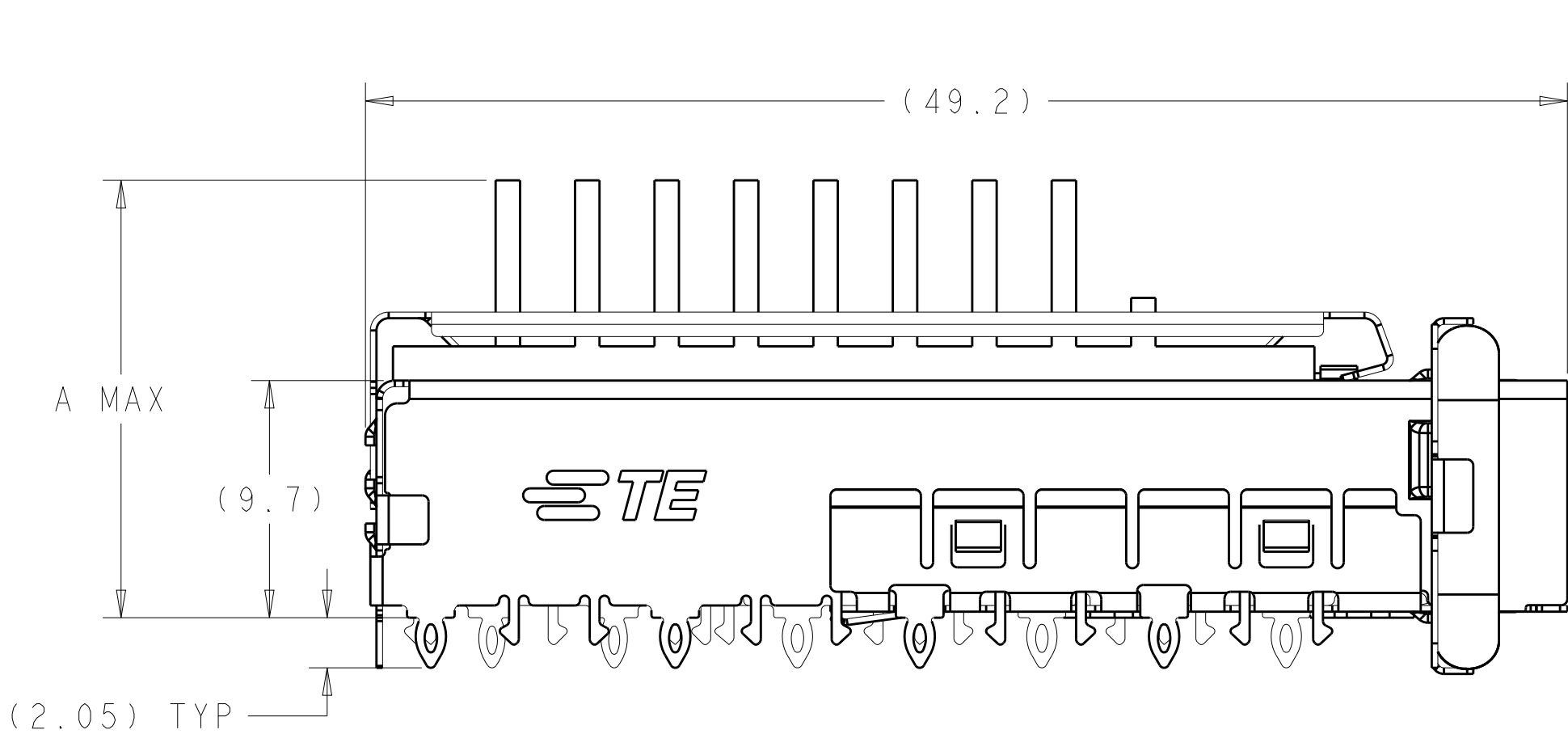
9 HOLE PATTERN REPEATS FOR EACH PORT. SPACING BETWEEN PORTS IS 14.25mm.

10 MINIMUM PC BOARD THICKNESS:
SINGLE SIDED: 1.45mm

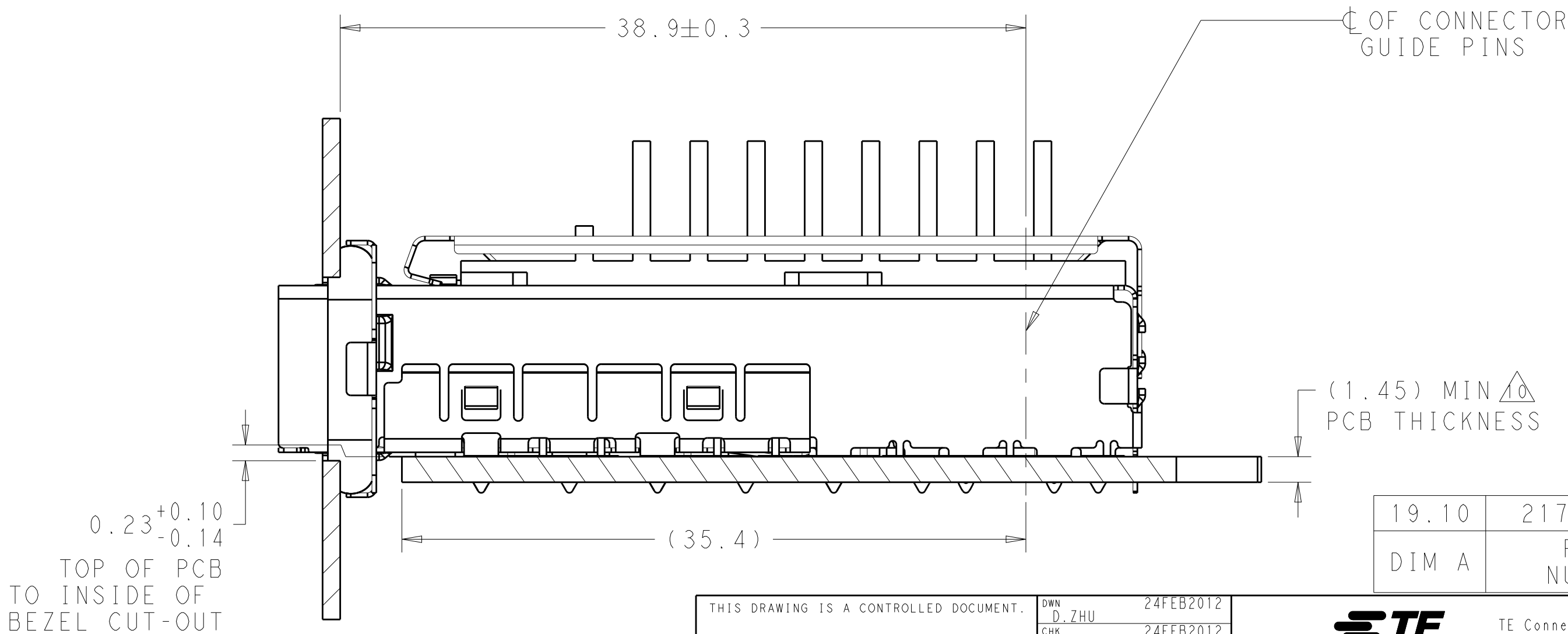
11. CERTAIN MATING TRANSCEIVERS MAY REQUIRE ADDITIONAL PCB THICKNESS THAT WOULD NEED TO BE DETERMINED BY THE CUSTOMER.

12. PRODUCT COMPLIES WITH SPECIFICATION SFF-8433 IMPROVED PLUGGABLE FORM FACTOR FOR SFP+ GANGED CAGES.

13 DIMENSION APPLIES WITH SFP MODULE INSERTED.



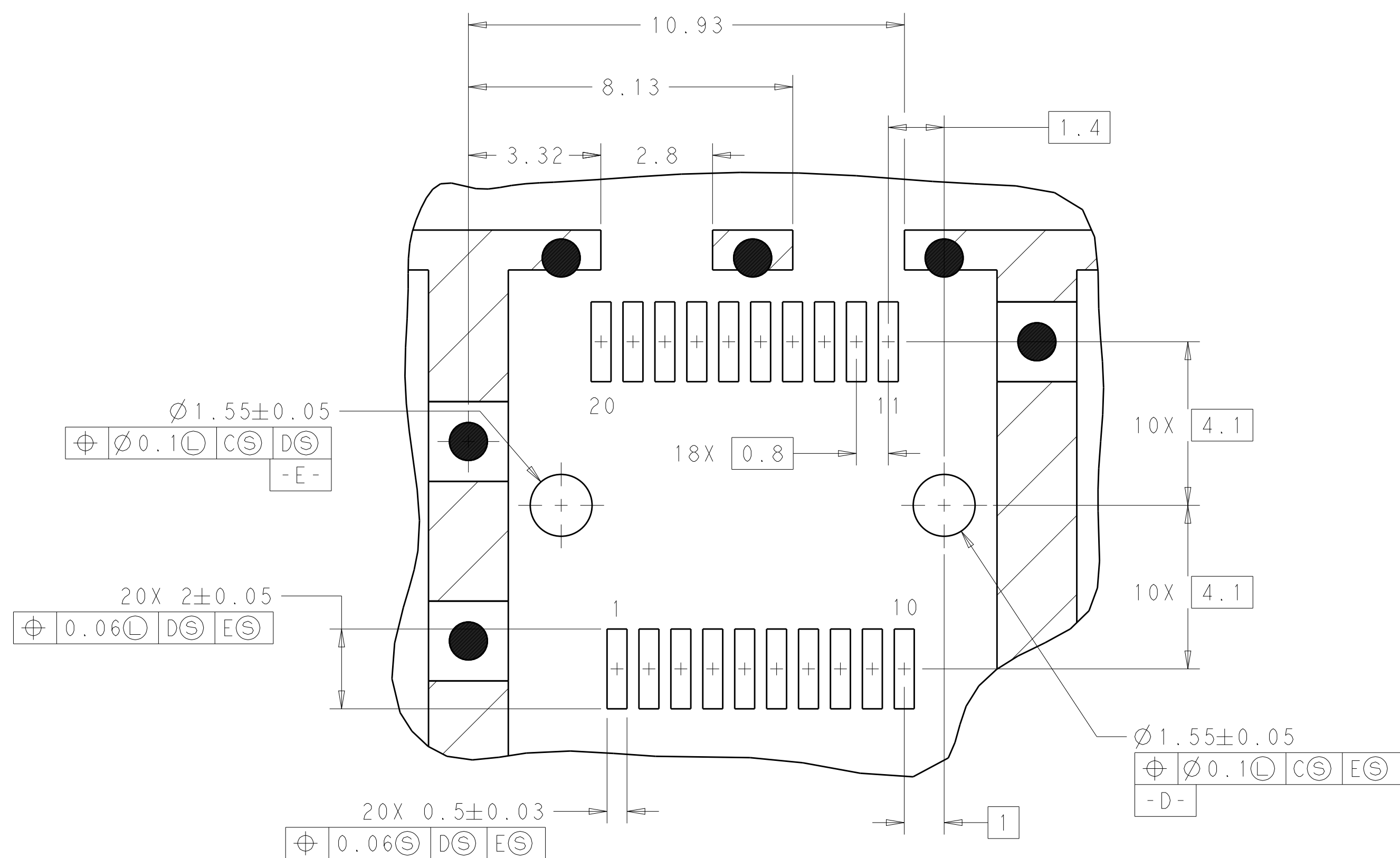
RECOMMENDED BEZEL CUT-OUT
SCALE 2:1



2170274-1
MOUNTED ON PC BOARD SHOWN
THRU RECOMMENDED BEZEL
SCALE 4:1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN D.ZHU	24FEB2012	NAME SFP+ ENHANCED, 1X4 CAGE ASSEMBLY PRESS FIT, EMI GASKET WITH HEATSINK	
DIMENSIONS:		CHK D.ZHU	24FEB2012		
mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	APVD A.CAI	24FEB2012	SIZE	CAGE CODE
	0 PLC ±.1	PRODUCT SPEC		A1	00779
	1 PLC ±.1	108-2364		SCALE	1:1
	2 PLC ±.1	APPLICATION SPEC		SHEET	1 OF 3
	3 PLC ±.1	114-13120		REV	B2
	4 PLC ±.1	WEIGHT			
MATERIAL	FINISH	Customer Drawing			

4805 (3/11)



DETAIL Z
RECOMMENDED PT CONNECTOR LAYOUT
4X INDIVIDUALLY PLACED
SCALE 10:1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN 24FEB2012 CHG D.ZHU 24FEB2012 APP'D D.ZHU 24FEB2012 A.CAI		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME SFP+ ENHANCED, 1X4 CAGE ASSEMBLY PRESS FIT, EMI GASKET WITH HEATSINK	
		0 PLC ±.1 1 PLC ±.1 2 PLC ±.1 3 PLC ±.1 4 PLC ±.1 ANGLES ±.1 FINISH		PRODUCT SPEC 108-2364 APPLICATION SPEC 114-13120 WEIGHT -	
MATERIAL -1		-2		SIZE CAGE CODE DRAWING NO A100779 C-2170274	
Customer Drawing		SCALE 1:1		SHEET 3 of 3 REV B2	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9